股票代號 **7828**

INNOS®
創新服務股份有限公司

創新服務(股)公司

115年第一季 營運概況及未來展望

2026/6

免責聲明

- 本公司基於簡報當時之主客觀因素，對過去、現在及未來之營運進行彙總與評估；其中含有前瞻性之論述，將受風險、不確定性及推論等所影響，容有超出本公司得以控制之部分，致實際情況或結果可能與上揭前瞻性論述大相逕庭。
- 本簡報所提供之資訊（包含但不限於對未來之看法），並未明示或暗示地表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性，亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。
- 本簡報中對未來之展望，僅反應本公司截至發表時點之看法；嗣後若有任何變更或調整，本公司不負提 醒及更新之責任。
- 本簡報及其內容非經本公司事前書面同意，任何第三人不得逕行援用或擷取之。

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

目錄

1. 公司簡介及經營理念
2. 產業及營運概況
3. 115年Q1實績及未來展望

INNOS
創新服務股份有限公司

股票代號 7828

1.公司簡介及經營理念

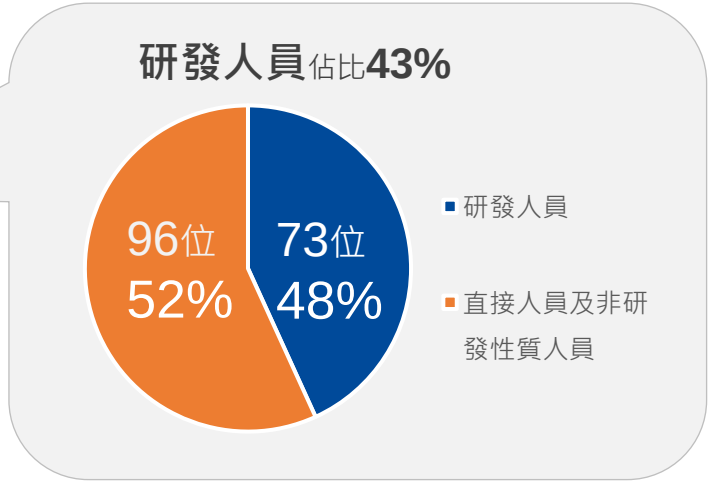
創新服務為您的製程創新、產品創新，

提供最專業整體解決方案。

公司簡介

創新服務股份有限公司
InnoStar Service, Inc.

- 創新服務成立於 2004 年
- 資本額：新台幣4.05億元
- 員工數：169人
  （截至115/4）
- 服務據點
  - 新竹廠
  - 台中總廠
  - 高雄辦公室
- 營業項目
  - 半導體自動化設備開發、製造及銷售業務。
  - 先進封裝解決方案。
  - 先進封裝製程元件、製造及銷售業務。
  - 探針卡維修與材料服務與銷售業務。





© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

公司里程碑

2004
- 公司成立
- 推出第一代塑膠剪切機。
- **開啟光學產業自動化革命**

2014
- 切入半導體先進測試製程，開發半導體晶圓級測試MEMS探針卡自動植針設備
- **開啟探針卡植針自動化革命**

2016
- 取得半導體晶圓國際大廠MEMS探針植針代工業務，已累積超過3億根針經驗。
- 自動化植針設備獲得主要探針卡大廠採用

2022
- 高密度銅柱端子模組，應用於WIFI模組大量送樣。
- 探針卡廠大量採用植針設備。



2024
- 高密度銅柱端子模組，應用於Power Module, TGV, PLP模組。
- TP成為策略投資人
- 推出MEMS探針卡Probe Card整體自動化維修解決方案



2025
- **高密度銅柱端子模組各項產品進行驗證與準備量產。**

2026
- **MEMS探針卡Probe Card系列設備機台開發完成。**
- **Probe Card維修產能建置完成與投入**

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

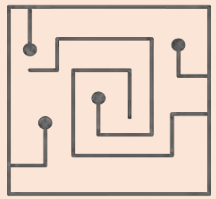
INNOS
創新服務股份有限公司

股票代號 7828

2. 產業及營運概況

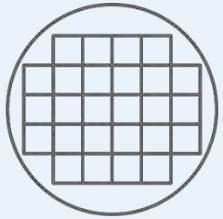
產業概況

上游



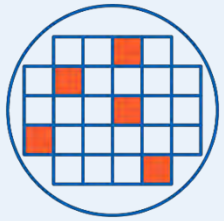
IC設計
代工服務

中游

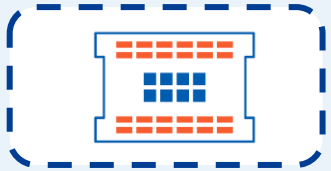


IC/晶圓製造

生產製程及檢測設備 | 光罩 | 化學品



IC檢測
(Chip Probing)



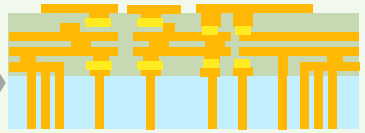
探針卡晶圓測試

下游

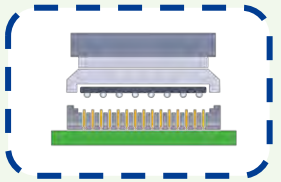


IC 封裝
Package

生產製程及檢測設備 | 基板 | 導線架



IC 測試



FT終端測試

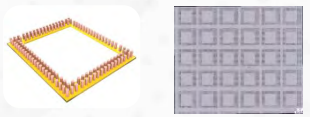
IC通路



探針卡植針
及相關自動化設備



CoWoS基板
元件返修設備



高密度
銅柱端子



Pogo Pin植針
及相關自動化設備

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

產 品

探針卡
整線設備自動化方案

- 探針卡雷射鑽孔機
- 鑽孔檢查&陶瓷卡自動貼合
- MEMS探針卡雙臂植針機
- 探針卡IPQC檢查機
- 探針雷射塑形機、雷射探針卡清潔機
- 探針卡自動換針機
- 探針分選及整列機
- 探針卡分析測試機
- CoWoS FT自動化植針(90um)、檢測機



MEMS探針卡維修線

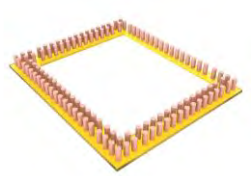
半導體
精密加工

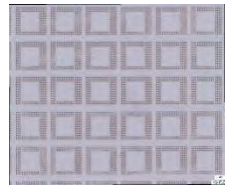
- 精密雷射切割設備
- Mini LED自動化檢測與雷射返修設備
- 精密雷射除膠機
- MEMS Mirror自動化精密組裝設備
- CoWoS基板元件返修設備
- 精密碰焊機

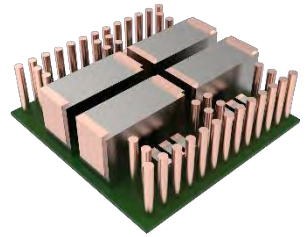


先進封裝

- WIFI Module高密度銅柱端子
- Power Module高密度銅柱端子
- Interposer (10:1)銅柱TGV







© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

MEMS探針卡整線設備自動化方案

INNOS探針卡生產與維修關鍵整線設備

探針卡
雷射鑽孔機 → 鑽孔檢查
&陶瓷卡自動貼合機 → MEMS探針卡
雙臂植針機 → 探針卡
IPQC檢查機 → 探針雷射塑形機、雷射清潔機 → 探針卡
自動換針機 → 探針分選
及整列機

開發完成 | 預計2026 Q1完成 | 開發完成 | 開發完成 | 開發完成 | 開發完成 | 開發完成



雷射鑽孔機 → 人工&
半自動貼合 → 人工插針 → 顯微鏡
下人工檢 → 半自動雷射清潔 → 人工作業
換針及量測 → 人工篩選

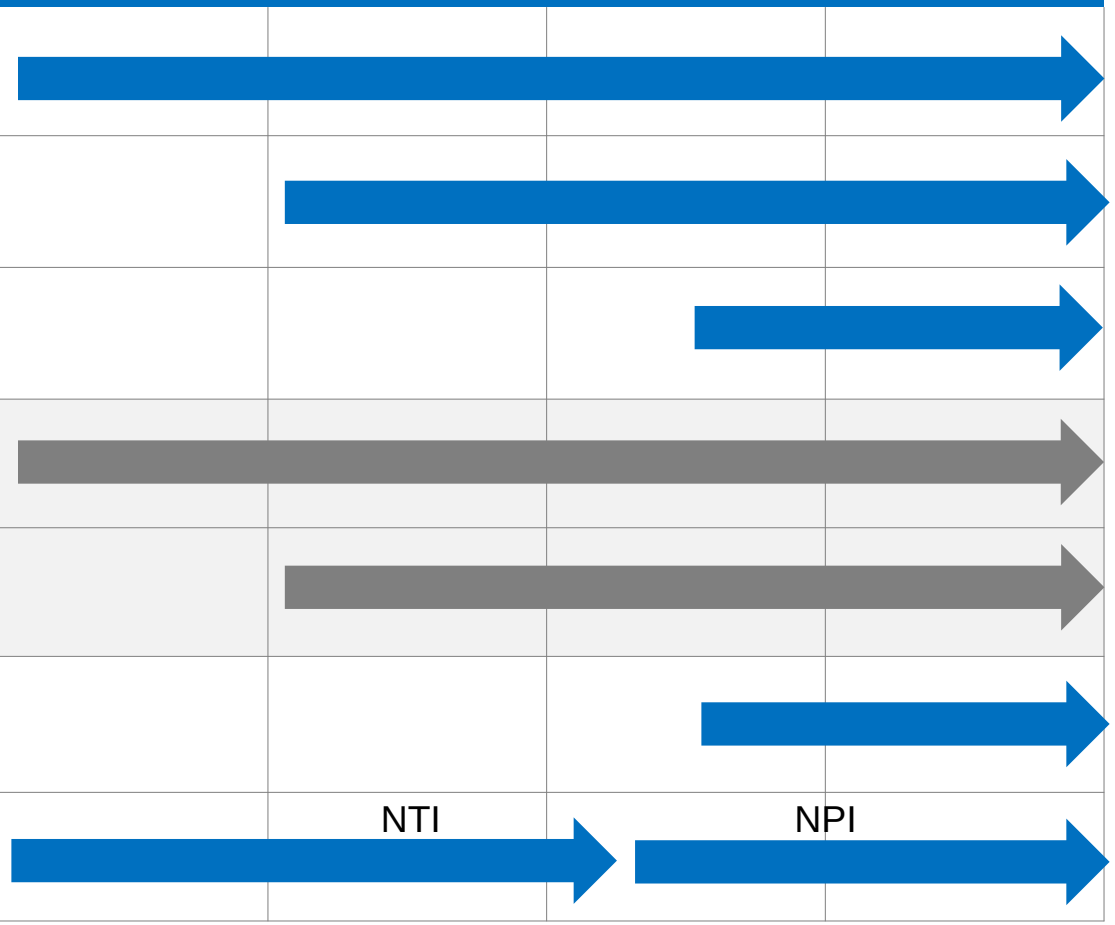
傳統 探針卡生產方式

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

創新三引擎產品線

股票代號 **7828**

#	MEMS探針卡相關業務 產品名稱	客戶群
探針卡 自動化設備	1. 雙Arm植針機	TP集團
	2. 探針卡返修機系列: 換針機,塑針機,檢查機,雷射清潔機,分選及整列機	TP集團
	3. 探針卡自動化加工設備: 雷射鑽孔機,自動對位貼合機,整形機,電測機,調針機	TP集團
材料包及代工	1 探針卡代工: 植針/塑針/維修	TP聯盟
	2. 探針卡材料包銷售	TP聯盟
銅柱 產品	1. 銅柱模組: AiP, Power Module	穿戴裝置IC廠 天線模組廠 電源管理模組廠
	2. TVG-ICP (Cu pillar inserted) core layer substrate	網通晶片公司



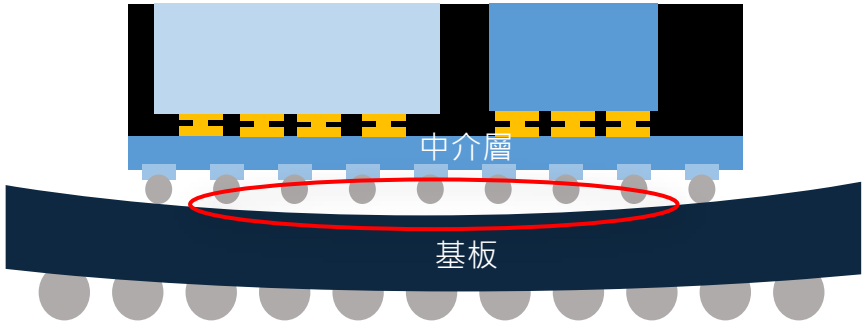
© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

銅柱巨量轉移技術 玻璃核心基板應用

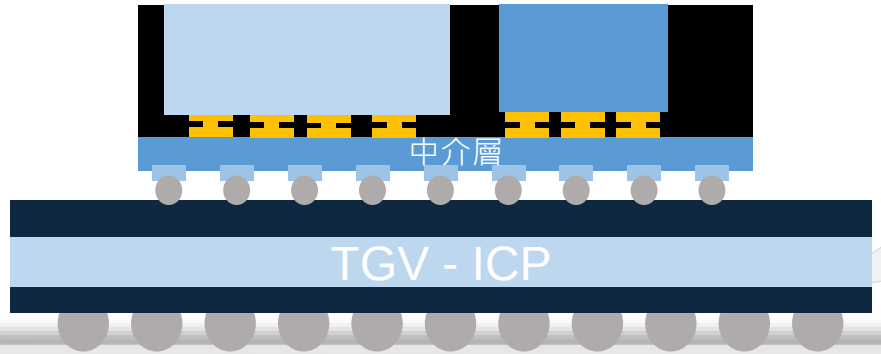
TGV-ICP (Through Glass Via with Inserted Cu Pillar)

TGV – ICP應用於基板(Substrate)中, 可滿足CoWoS系列(-S/R/L), CoPoS, 或其他需要大尺寸基板的先進封裝製程

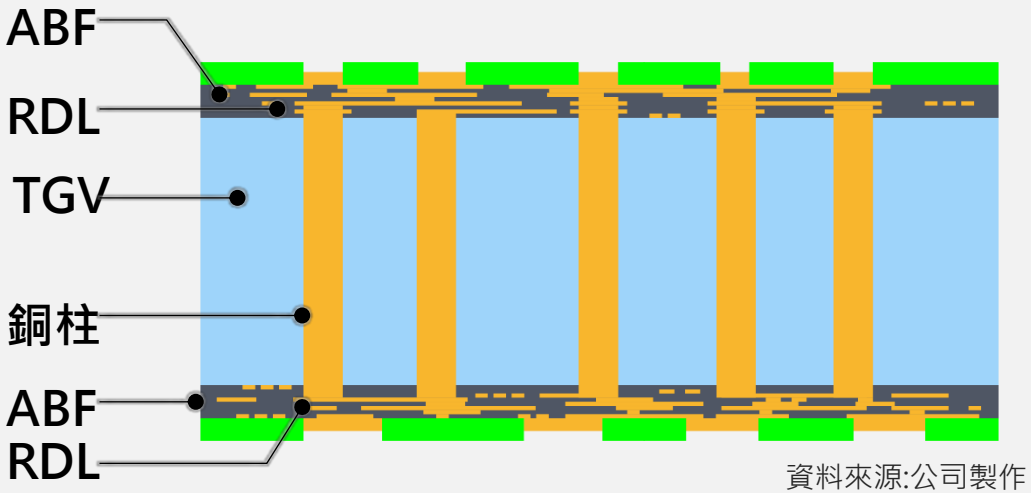
傳統有機載板，因多層材料的熱膨脹係數（CTE）差異過大，導致有機載板產生翹曲。



TGV-ICP為玻璃核心, 剛性強不翹曲



銅柱玻璃核心(TGV – ICP)基板

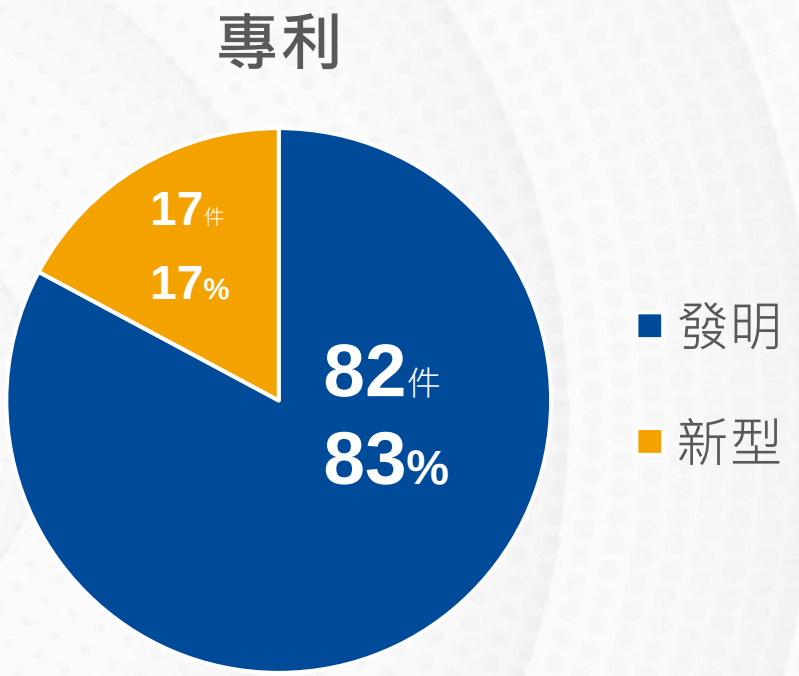


資料來源:公司製作

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

專利成果

專利項目	已取得		審查中	
	發明	新型	發明	新型
半導體 先進製程設備	15	1	5	1
先進封裝設備 及相關產品	14	7	23	0
其他	14	8	11	0
小計	43	16	39	1



截至目前為止，本公司已取得59件專利(發明43件、新型16件)，另有40件專利申請中(發明39件、新型1件) 。

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

INNOS®
創新服務股份有限公司

股票代號 **7828**

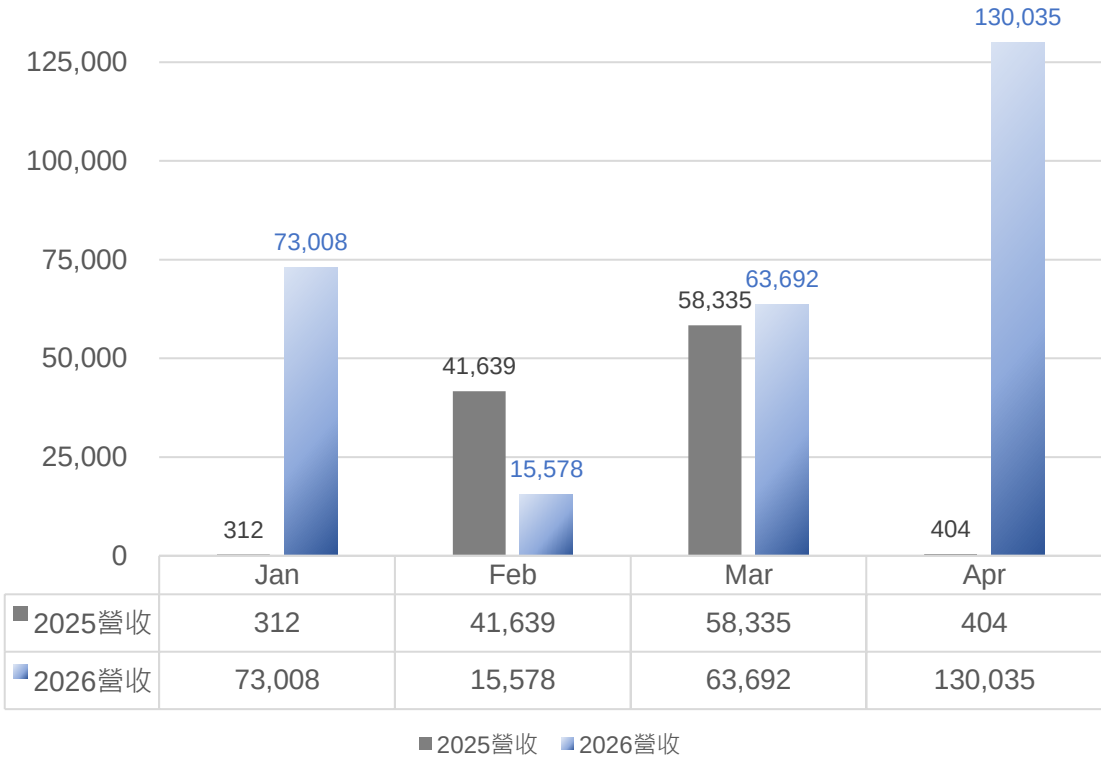
3.115Q1實績及未來展望

經營實績

單位：NTD 仟元；元

	114Q1	114Q4	115Q1
營業收入	100,286	394,369	152,278
毛利率	61.80%	79.36%	80.18%
營業利益率	15.43%	51.11%	25.30%
EPS	0.49	4.91	1.02
EBITDA Margin	28.48%	55.83%	37.80%

單位：NTD 仟元



- 115Q1營收YoY成長51.84%，主係半導體先進製程技術演進、受惠AI應用之終端客戶需求強勁，本公司成功開發出MEMS探針卡雙臂植針機及整線設備自動化解決方案，使MEMS探針卡相關設備持續穩健出貨， 維持高毛利率、營收成長上升趨勢。
- 115Q1營業費用高於去年同期，主係營收成長、擴編員工、以及相應營收與獲利成長所提撥的員酬/獎金、董酬所致。

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

未來展望-營運成長「三引擎」

半導體MEMS探針卡自動化設備

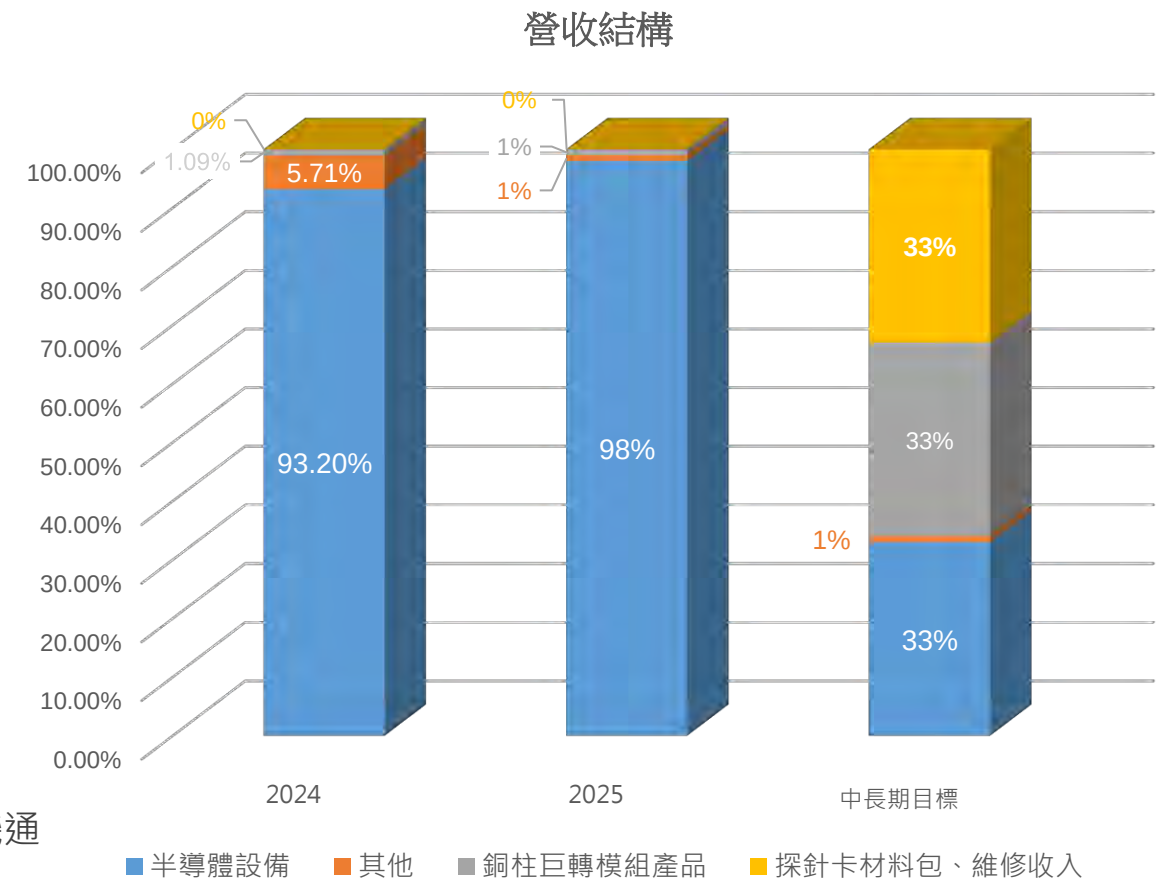
- 雙ARM植針機受惠終端客群成長力道加強，未來出貨將呈正向大幅成長。
- 探針卡維修自動化相關設備陸續驗證完成出貨，將於2026年下半年帶來新一波成長力道。
- 新一波探針卡相關先進設備已進行開發，下半年陸續進行驗證, 預期未2027年挹注營收。

探針卡材料包及維修

- 成功導入數家探針卡大廠，引入TP MEMS探針並提供後續維修服務。
- 自動維修產線已啟動，提供客戶快速高效返修服務，大幅縮減lead time。

銅柱巨轉模組

- 創新銅柱方案，專注Power 模 組 及 TGV CoWoS 封裝等市場。
- 2026底開始量產銅柱模組,應用於天線模組AiP、Power模組及穿戴式耳機通訊模組等。
- 2027年底可逐步量產TGV-ICP核心玻璃基板產品, 應用於高速傳輸晶片封裝。



© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

THANK YOU For Your Attention